

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-075

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于公司向银行申请融资及第三方提供担保、子公司反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展概述

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）申请累计不超过人民币8亿元的授信额度，并为全资子公司的融资提供合计人民币不超过5亿元的担保额度。具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该决议已经2020年度股东大会批准。

近日，公司向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）申请流动资金贷款，融资额度为人民币1,500万元，融资期限为12个月，本次授信由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）提供连带担保，追加实际控制人赵积清先生个人连带责任担保，追加新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）、惠伦晶体（重庆）科技有限公司连带责任担保。具体贷款金额、时间及利率以公司与平安银行深圳分行签订的正式贷款合同为准。此外，实际控制人赵积清先生、惠伦晶体（重庆）科技有限公司、新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）向高新投提供连带责任反担保。

平安银行深圳分行、高新投与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次融资事项在董事会审批额度内，并已由董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资关的一切事宜，无需再提交董事会审议。

二、子公司为深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保相关情况

（一）反担保对象基本情况

- 1、名称：深圳市高新投融资担保有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300571956268F
- 3、注册资本：700,000 万元人民币

4、法定代表人：刘苏华

5、住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

6、成立日期：2011 年 4 月 1 日

7、经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

8、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	851,262.20	857,582.26
负债总额	88,348.53	87,257.31
净资产	762,913.67	770,324.95
项目	2020 年 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	62,507.71	6,198.81
利润总额	48,479.21	5,400.27
净利润	35,574.12	2,813.42

(二) 反担保内容

公司的全资子公司惠伦晶体科技(重庆)有限公司向高新投提供反担保，最终反担保数额、反担保期限等内容以惠伦晶体科技(重庆)有限公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署的相关协议为准。

三、累计综合授信额度情况

如本次交易完成后，公司及子公司已签署的融资协议涉及的累计融资金额为人民币 56,200 万元，本次融资事项在董事会审批额度内，由董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资有关的一切事宜，无需再提交董事会审议。

四、交易目的及对公司的影响

公司进行项目融资交易，能够有效补充公司流动资金，促进经营发展。本次办理融资业务，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、平安银行股份有限公司流动资金贷款批复
- 2、深圳市高新投融资担保有限公司担保意向书

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021年8月13日